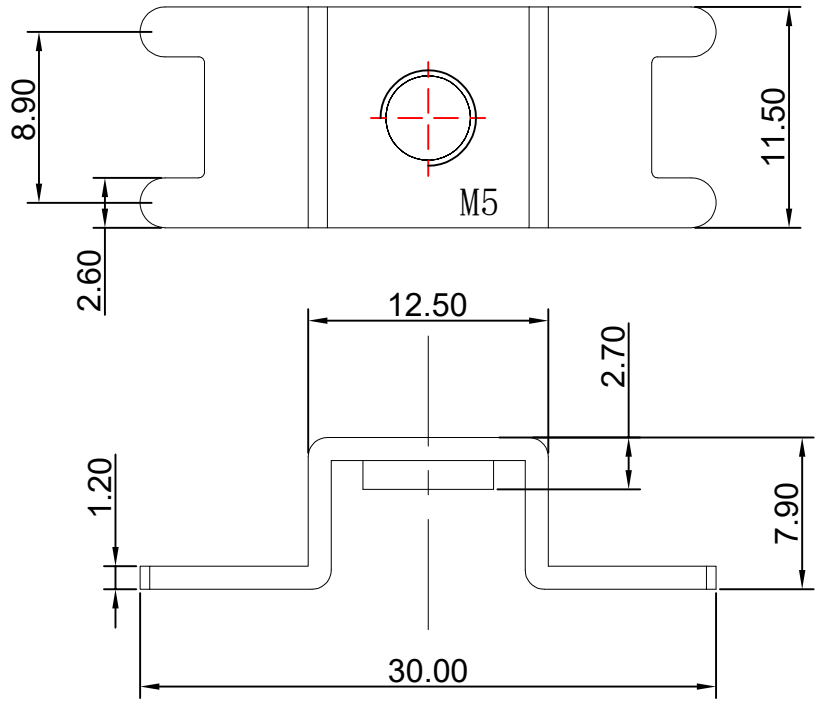
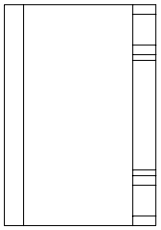
RoHS

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	新版发行			2026.08.06





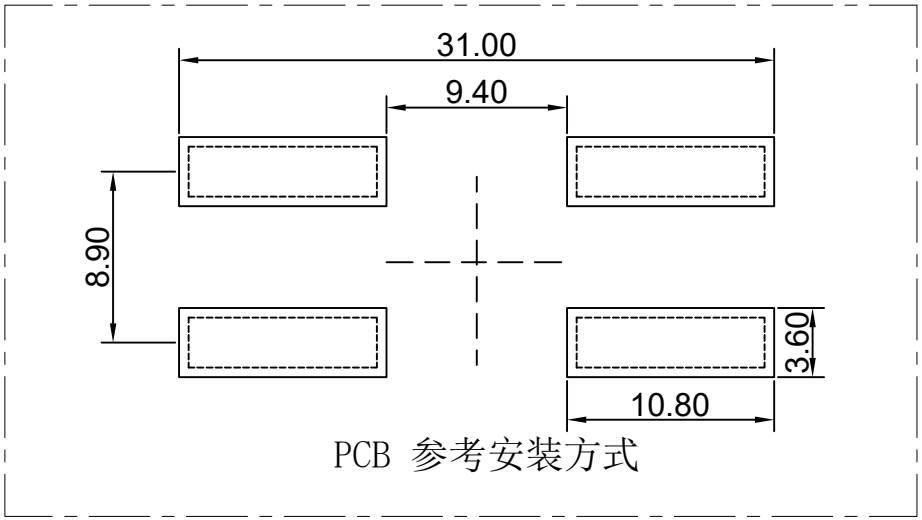
技术要求：

1.打铜底0.5-1μm,镍2-2.5μm，镀雾锡3-5μm。
2.铆好后不得有松动现象。
3.插脚尖部符合可焊性要求。
4.螺纹需符合通止规/止针要求。
5.螺纹扭矩：1.8Nm.
6.额定电流 ：90A.

料号说明：

TS54300115-0790-XXXX
1 2345

1.序列号
2.电镀 W=雾锡（默认不显示）
L=亮锡
Y=镀银
3.材质 0=黄铜 （默认不显示）
2=紫铜
4.主体 0=焊接端子（默认不显示）
S=焊接端子+螺丝(分开包装）
NS=焊接端子+螺丝(螺丝扭配好）
5.logo 0=no logo（默认不显示）
1= with logo



PCB 参考安装方式

1	插脚		H62(Y2)	1
序号	名称	零件编号	材质	数量

＞30.±0.4	X.°±
6-30±0.3	.X°±
0-6±0.2	.XX°±
ANGLES±1°	.XXX°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: TS54300115-0790

TITLE: PCB SOLDERING TERMINAL

APPD	Chen ZhiQiang		
CHKD	Liu Wei	VIEW	
DRAW	Chen HongJiang	SCALE	SHEET / REV
DATE	2026.08.06	NONE	1/1 / A1

XFCN 兴飞连接器
0769-82001899
www.xfconn.com

DWG NO: /